

## Leiterplatten besser produzieren

### LPKF zeigt auf der Productronica 2021 Neuheiten für die Leiterplattenproduktion

**Ansprechpartner:**

Cordula Krause-Widjaja  
cordula.krause-  
widjaja@lpkf.com  
Tel. +49 (0)5131 7095-1327  
Fax +49 (0)5131 7095-90

**LPKF**  
**Laser & Electronics AG**  
Osteriede 7  
D-30827 Garbsen  
www.lpkf.com

**Vorstand:**

Christian Witt  
Britta Schulz

**Aktie:**

Prime Standard  
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» [Weitere Pressemeldungen](#)

„Endlich wieder echten Kontakt zur Electronics-Production-Community und Austausch mit Kunden, Interessenten und dem Markt allgemein“: LPKF freut sich, nach Monaten mit Webinaren, Online-Kontakten und rein virtuellen Veranstaltungen auf der diesjährigen Productronica 2021 wieder vor Ort präsent zu sein - und möglichst viele Messestandbesucher begrüßen zu können.

Für das **Nutzentrennen** präsentiert das Technologieunternehmen auf der Messe eine **Automatisierungslösung**, mit der bestückte Leiterplatten noch schneller und kosteneffizienter mit dem Laser geschnitten werden – und das mit einer unkomplizierten Linienintegration. Eine neu konzipierte, **bahnbrechende Weiterentwicklung** der Laser-Nutzentrenn-Technologie ermöglicht darüber hinaus eine erhöhte Schneidgeschwindigkeit mit qualitativ hochwertigsten Ergebnissen. Dies findet sich vereint in einer **neuen Systemvariante** der bewährten **Serie LPKF CuttingMaster 2000** – und wird auf der Messe erstmals vorgestellt.

LPKF zeigt auf der Messe außerdem, wie schnell und einfach Leiterplatten im eigenen Labor hergestellt werden können. Mit Fräsbohrplottern und Lasermaschinen für das **PCB Prototyping** sowie Equipment für SMT-Anwendungen bestückt das Unternehmen bereits seit Jahrzehnten Labore und Entwicklungszentren in Industrie und Wissenschaft. Als Beispiel eines Lasersystems für das Prototyping besonders empfindlicher Materialien wird auf dem Messestand der **LPKF ProtoLaser U4** zu sehen sein. Dieses Lasersystem verwendet einen speziell für den Einsatz im Elektroniklabor entwickelten scannergeführten Laser mit einer Wellenlänge im UV-Spektrum. Es kann Prototypen in Hightech-Qualität herstellen – ohne zusätzliche Werkzeuge, Masken oder Filme. **In einem Gewinnspiel lockt als Hauptpreis ein Fräsbohrplotter LPKF E44.**

Mit einem raumsparenden, einfachen und dabei zuverlässigen Verfahren für das Advanced Packaging von integrierten Schaltkreisen – dem **Active Mold Packaging (AMP)** - beteiligt sich LPKF u.a. schon jetzt an der Entwicklung des **kommenden 6G Telekommunikationsstandards**.

Im Geschäftsfeld **Laser-Kunststoffschweißen** sieht LPKF viele Überschneidungen mit der Elektronikproduktion – sei es beim Schweißen von Leiterplatten-Housings oder beim Fügen von Kunststoffen, die das innovative Feld der E-Mobility bereichern.

Eine echte Weltneuheit hat LPKF hier im Gepäck: Mit LPKF-Systemen lässt sich jetzt spezielles LDS-Material fügen. LDS, die Laser Direktstrukturierung, ist ein führendes Verfahren in der MID-Technologie. Direkt auf der Oberfläche von spritzgegossenen Bauteilen lassen sich damit Leiterbahnen erzeugen und so mechanische und elektronische Funktionen direkt auf einem Formteil integrieren. Durch die neue Füge-Möglichkeit öffnet LPKF Türen auf dem Weg zu weiterer Flexibilität, Miniaturisierung und Funktionsintegration.

Auch der LPKF-Bereich **LaserMicronics**, der Dienstleistungen rund um die Mikromaterialbearbeitung und das Laser-Kunststoffschweißen anbietet, präsentiert seine Services am Messestand.

Wie in den letzten Jahren ist der Laser-Spezialist auf der diesjährigen Productronica wieder in **Halle B2 am Stand 303 zu finden**.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter [www.lpkf.com](http://www.lpkf.com).



**Bildunterschrift:** Mit den LPKF-Lasersystemen für das Depaneling sind saubere Leiterplatten-Schnittkanten schnell realisierbar.

### **Über LPKF**

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.